



九州中部

熊本

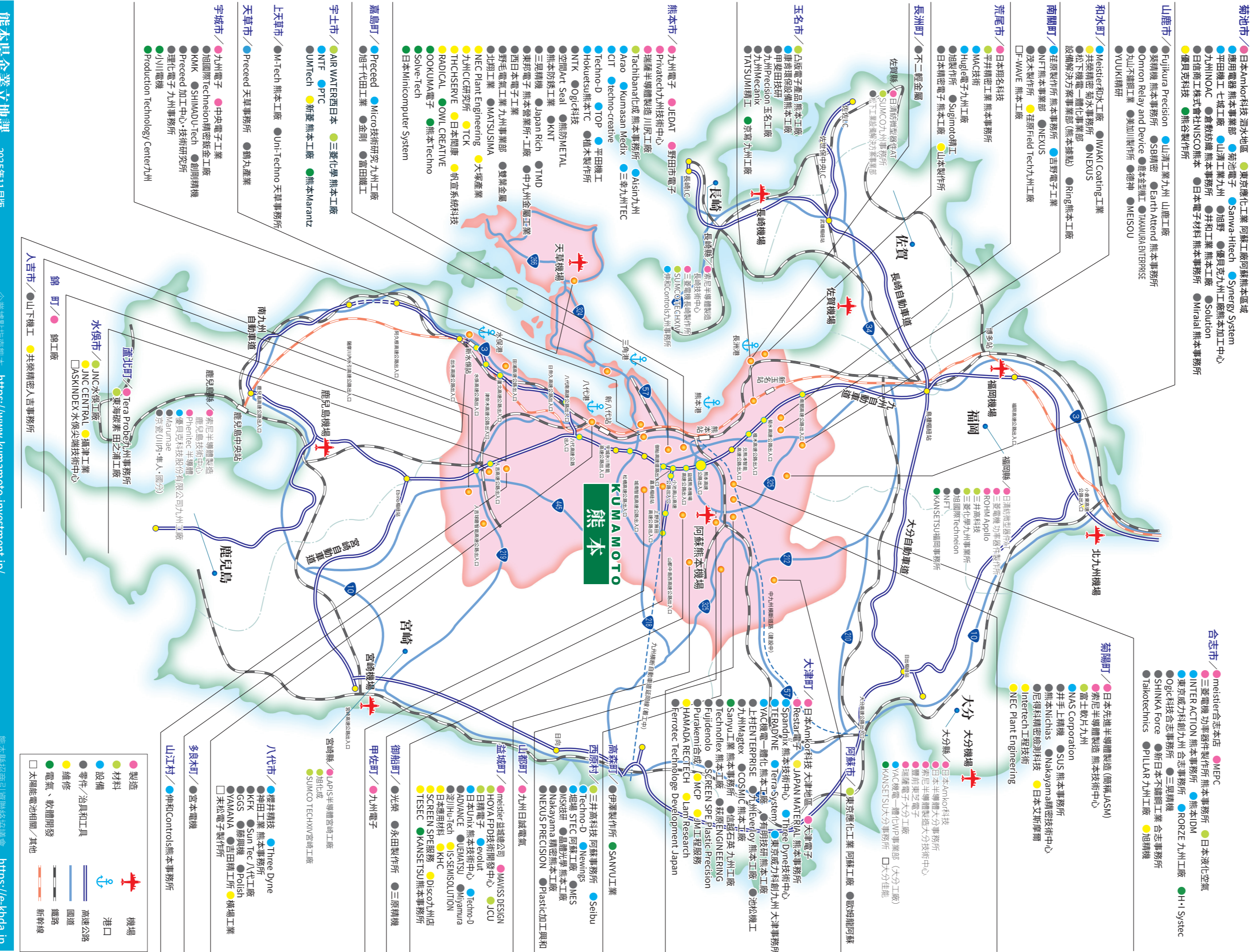
支持電子設備產業的有力據點

公司選址指導

矽島九州 熊本企業地圖

矽島九州

主要半導體相關公司位置圖



熊本縣內相關企業與合作企業群

零件加工 (機械加工、支架、框架等)	<ul style="list-style-type: none"> 葵精機株式會社 旭野有限公司 有明技術株式會社 井手上精機株式會社 池松機工株式會社 植木製作所株式會社 msk技研有限公司 MES株式會社 甲斐田技術株式會社 神田工業株式會社 九州MAGTEX株式會社 KMK株式會社 金剛株式會社 Suntech株式會社 SHINKA Force株式會社 Sugimoto精工株式會社 株式會社創剛精機 Solution株式會社 Taikotechnics株式會社 Takamura Enterprise株式會社 有限會社TMD 株式會社富田鐵工 Nakayama精密株式會社 日本精密電子株式會社 Nexus Precision株式會社 萩原工程技術株式會社 Fujikura Precision株式會社 株式會社Matsushima 三原精機株式會社 山下機工株式會社 有限公司YAMANA 有限公司吉田精工所
板金・沖壓加工	<ul style="list-style-type: none"> 旭國際Technion株式會社 Advance株式會社 UEMATSU株式會社 NTK有限公司 九州Mechanics株式會社 KN科技株式會社 三兒精機株式會社 Shimazu科技株式會社 新日本不銹鋼工業株式會社 Tatsumi精工株式會社 中九州金屬工業株式會社 永田製作所有限公司 雙葉金屬株式會社 北翔工業株式會社 丸山不銹鋼工業株式會社 株式會社茂木製作所 UM科技株式會社
模具、治具和工具， 檢具治具設計・製造	<ul style="list-style-type: none"> SB精密 鹿本金屬模具有限公司 KFK株式會社 株式會社Japan Rich 株式會社GGS 德神株式會社 日精電子株式會社 Meisou株式會社 Yuki精研株式會社
樹脂・注塑產品加工 (切削、射出成形、熔接等)	<ul style="list-style-type: none"> 株式會社伊澤製作所 上村Enterprise株式會社 株式會社九州INOAC 有限公司空間ART SEAL 株式會社SCREEN SPE Plastic Precision Three Dyne株式會社 Nexus株式會社 藤興機株式會社 FUJI denolo株式會社 Miyamura株式會社 Plastic加工興和株式會社
表面處理、熱處理等	<ul style="list-style-type: none"> 旭千代田工業株式會社 Ogc技術株式會社 熊本防鏽工業株式會社 熊防金屬株式會社 株式會社野毛電氣工業 美加川製作所株式會社
設備設計・製造・維護相關 (包括製罐)	<ul style="list-style-type: none"> NEC Plant Engineering株式會社 JNC Central株式會社 攝津工業株式會社 帆宣系統科技有限公司 橫場工業株式會社
電氣(電路設計)， 電子(電路和組件)， 軟件開發	<ul style="list-style-type: none"> 株式會社OWL CREATIVE HI SYSTEC株式會社 Ookuma電子株式會社 小川電機株式會社 株式會社Kansetsu 熊谷製作所有限公司 熊本科技株式會社 熊本Marantz株式會社 SANYU工業株式會社 株式會社Solve-Tech 日本Mini Computer System株式會社 株式會社Production Technology Center九州

*上述為《熊本縣半導體各製造流程企業列表》登載企業以外的相關企業與合作企業。
製作協助單位・公益財團法人熊本產業支援財團
<https://www.kmt-ti.or.jp>

熊本縣企業立地課
 郵遞區號862-8570 熊本市中央區水前寺6-18-1
 電話+81-96-333-2329, 2330
 傳真+81-96-385-5797
 電子郵件:kigyourichika@pref.kumamoto.lg.jp

熊本縣東京事務所 熊本商業推進課
 郵遞區號104-0061 東京都中央區銀座5-3-16
 銀座熊本館3樓
 電話+81-3-3572-5022 傳真+81-3-3574-6714
 電子郵件:ginzakumamoto@pref.kumamoto.lg.jp

熊本縣大阪事務所
 郵遞區號530-0001 大阪市北區梅田1-1-3-2100
 大阪站前第3棟21樓
 電話+81-6-6344-3883 傳真+81-6-6344-3807
 電子郵件:oosakajimu@pref.kumamoto.lg.jp

URL <https://www.kumamoto-investment.jp>

出自熊本縣出身的書法家 武田雙雲之筆，象徵著熊本人與大自然所擁有的力量與熱情。
 熊本縣始終站在企業的立場，致力於招商引資，讓熊本成為企業首選。

2025年11月版



熊本縣半導體各製造流程企業列表

塗抹光致抗蝕劑

在晶圓表面滴上光致抗蝕劑，進行高速旋轉，使其表面形成1微米左右的薄

對齊光罩/曝光

把晶圓上的圖案和光罩圖案對齊，照射紫外線，把光罩圖案轉印到晶圓上。

顯影

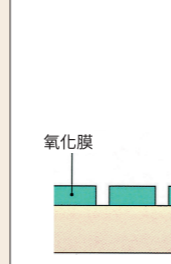
用溶劑將曝光區域的抗蝕劑溶解。

蝕刻

按照光致抗蝕劑的圖案，選擇性地去除氧化膜。

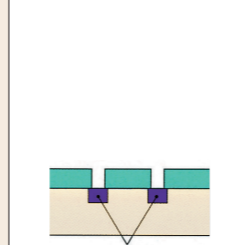
洗滌

除去光阻劑，以純水洗淨。



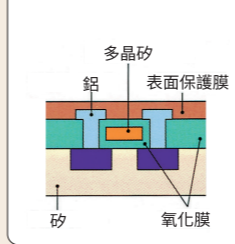
注入雜質

將“硼”、“磷”等雜質離子化，注入到矽片的規定位置，形成擴散層。



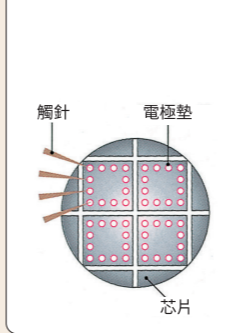
金屬成膜

為了把經過重複多次氧化和擴散過程後製作出來的電晶體、電阻、電容等元件連接起來，要使用鋁薄膜形成佈線，最後塗上表面保護膜以保護佈線。



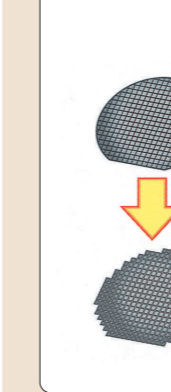
晶圓檢查

在製成的晶圓上形成了多個IC芯片，對每個芯片的質量進行篩選。



切割

將晶圓一個一個切開。



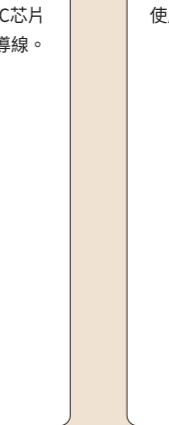
安裝

將IC芯片裝在導線架上。



接合

用超細金銅線連接IC芯片的電極與導線架的導線。



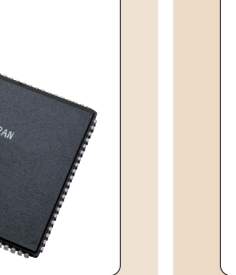
封裝

使用模具樹脂等封裝IC芯片。



封裝電鍍/精加工

用模具樹脂等覆蓋後，電鍍外部導線，印上製造廠商名稱，logo，產品名稱，製造年月日等。剪切芯片後，將導線進行彎曲加工。



最終測試

對產品進行電氣特性檢查及可靠性測試。

